申復理由書

一、貴局114年7月2日審查意見通知函敬悉。

申請案號：第113149253號

發明名稱：一種檢測無缺陷晶圓及其缺陷的偵測方法(修正後名稱)

經濟部智慧財產局函：

114年7月2日（114）智專二（物）04429字第11420698020號

二、修正申請專利範圍

(一)、將請求項8-10中的「晶圓」修改為「檢測無缺陷晶圓」。

(二)、將請求項2中的「通過紅外線激光散射層析方式按照設定的距離間隔測量每個檢測區間的晶體原生顆粒COP缺陷密度」修改為「通過所述紅外線激光散射層析方式按照設定的距離間隔測量每個檢測區間的晶體原生顆粒COP缺陷密度」。

(三)、將請求項5和請求項6中的「所述裂解樣品所在的待測晶圓的中心開始」修改為「所述裂解樣品所在的所述待測晶圓的中心開始」

三、修正說明書

(一)、將申請名稱、摘要和說明書中的「晶圓及其缺陷的偵測方法」修改為「檢測無缺陷晶圓及其缺陷的偵測方法」。

四、審查意見概要

(一)、審查意見包括：

1. 審查意見認為，本案請求項8~9標的名稱為一種晶圓，標的

名稱不明確(應敘明是何種晶圓，例如偵測無缺陷晶圓或是更適格貼近原請求項之技術內容之標的)，不符合專利法第26條第4項暨其施行細則第18條第2項之規定。

2. 審查意見認為，本案請求項2，所載「…通過『紅外線雷射散射層析方式』按照設定的…」，雙引號內容是否與請求項1記載「紅外線雷射散射層析方式」為相同技術構件？請檢視及釐清關係；另請求項5~6亦有相同情形發生，不符合專利法第26條第2項之規定。

3. 審查意見認為，本案請求項5，所載「…的『待測晶圓』的中心開始至沿所述待測晶圓半徑…」，雙引號內容是否與請求項1記載「待測晶圓」為相同技術構件？請檢視及釐清關係；另請求項6亦有相同情形發生，不符合專利法第26條第2項之規定。

五、本案的發明已依據審查意見修改本案請求項

(一)、申請人將請求項8-10中的「晶圓」修改為「檢測無缺陷晶圓」。

(二)、申請人將申請名稱、摘要和說明書中的「晶圓及其缺陷的偵測方法」修改為「檢測無缺陷晶圓及其缺陷的偵測方法」。

(三)、申請人將請求項2中的「通過紅外線激光散射層析方式按照設定的距離間隔測量每個檢測區間的晶體原生顆粒COP缺陷密度」修改為「通過所述紅外線激光散射層析方式按照設定的距離間隔測量每個檢測區間的晶體原生顆粒COP缺陷密度」。

(四)、申請人將請求項5和請求項6中的「所述裂解樣品所在的待測晶

圓的中心開始」修改為「所述裂解樣品所在的所述待測晶圓的中心開始」。

六、綜上所陳，經本次修正申請專利範圍，並參酌以上申復理由，可知本案所請各項發明應符合專利法之規定，並懇請早日准與專利。

謹呈

經濟部智慧財產局　公鑒